

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路4段195號

承辦人：黃一婷

電話：03-5913279

E-mail: YiTing23@itri.org.tw



110000367915

310401 新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館1246室

受文者：台灣半導體產業協會(TSIA)

發文日期：中華民國110年02月26日

發文字號：工研轉字第1100003679號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：檢送110年「無形資產評價廣宣說明會」3月份共計2場之議程，惠請轉知貴會會員，把握機會參與本活動，請查照。

說明：

- 一、本院執行經濟部工業局智慧財產價值躍升計畫(以下簡稱本計畫)，將於110年3月12日及26日辦理「無形資產評價廣宣說明會」共計2場次，惠請貴會轉發並邀請會員擇一場次報名參加(參見附件)。
- 二、說明會將介紹本計畫110年度「無形資產融資專案」，本專案訊息已於TWTM台灣技術交易資訊網公告，網址為<https://reurl.cc/R648ez>。
- 三、因應疫情，皆以線上會議形式召開。
- 四、本案聯絡人：唐小姐

電話：03-5913996 / 電子信箱：itriA30073@itri.org.tw

正本受文者：台灣半導體產業協會(TSIA)

院長

依權責劃分規定授權業務主管決行



依據產業創新條例第 13 條「推動無形資產投融资、證券化交易、保險、完工保證及其他事項」施行，經濟部工業局積極推動無形資產流通運用之完整生態系，本計畫特別舉辦說明會，將透過六大核心戰略產業相關公協會、中華民國工業區廠商聯合總會、中華民國會計師公會全國聯合會、中華民國專利師公會等，擴大邀請相關企業參加，以持續建構無形資產評價融資平台與擴散專利融資模式。

本說明會除了介紹無形資產融資企業申請與檢核機制外，亦邀請中小企業信用保證基金分享企業無形資產融資經驗，以及具專利融資或核貸經驗的銀行線上諮詢。期許透過與各產業企業先進直接交流，加速創新技術鏈結資金市場，歡迎各界踴躍報名。

無形資產評價廣宣說明會第一場次已圓滿落幕，目前開放兩場次，請擇一報名：

第二場次：2021 年 3 月 12 日（星期五）14：00－15：00，線上報名於 3 月 10 日 23：59 截止。

第三場次：2021 年 3 月 26 日（星期五）14：00－15：00，線上報名於 3 月 24 日 23：59 截止。

會議形式：線上會議（報名成功通知函附線上會議連結，於會議前三日以信件發送至報名信箱）

對象：歡迎中小企業、新創公司或產業公協會企業成員等，對無形資產評價融資有興趣的廠商參加。

時間	活動主題	主講人
13：30 - 14：00	會前連線測試與線上報到	-
14：00 - 14：15	無形資產融資企業申請暨檢核機制流程說明	工研院代表
14：15 - 14：30	無形資產融資保證資源	信保基金代表
14：30 - 14：45	109 年參與融資銀行線上諮詢	銀行代表
14：45 - 15：00	TWTM 台灣技術交易資訊網簡介	工研院代表
15：00 ~	活動結束	

（執行單位保留議程變更之權利）

線上報名網址：<https://forms.gle/YD48JDgswVvfcAA>

聯絡窗口：唐與菁小姐 / 03-5913996 / itriA30073@itri.org.tw



廣宣會報名 QR Code

個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書

工業技術研究院(簡稱：工研院)為蒐集、處理及利用基於執行經濟部工業局智慧財產價值躍升計劃之無形資產評價廣宣說明會事宜，您所提供或未來提供的個人資料(以下簡稱個資)，謹先告知下列事項：

1. 蒐集目的：執行經濟部工業局智慧財產價值躍升計劃之無形資產評價廣宣說明會報名與會後廠商需求追蹤事宜。
2. 個資類別：聯絡姓名、聯絡電話、聯絡 email、公司名稱及地址、企業統編。
3. 利用期間：自蒐集日起 35 日內。
4. 利用地區：中華民國。
5. 利用者：工業技術研究院。
6. 利用方式：工研院執行經濟部工業局智慧財產價值躍升計劃之無形資產評價廣宣說明會報名事宜聯繫；以及廣宣說明會舉辦完成之後續廠商需求追蹤時使用。
7. 您得以書面主張下列權利：
 - (一) 查詢或請求閱覽。
 - (二) 請求製給複製本。
 - (三) 請求補充或更正。
 - (四) 請求停止蒐集、處理或運用。
 - (五) 請求刪除。
8. 對工研院所持有您的個資，工研院會按照政府相關法規保密並予以妥善保管。

本活動為網路會議，為尊重智財權，全程不可採用任何方式錄音及錄影，敬請各位與會貴賓配合。